

NUMBER 178303

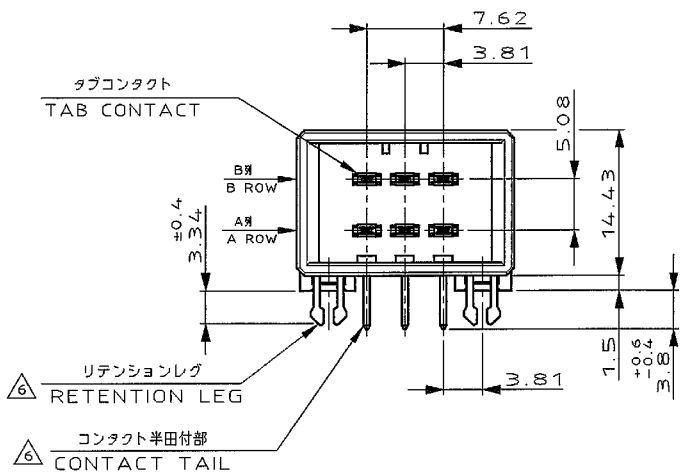
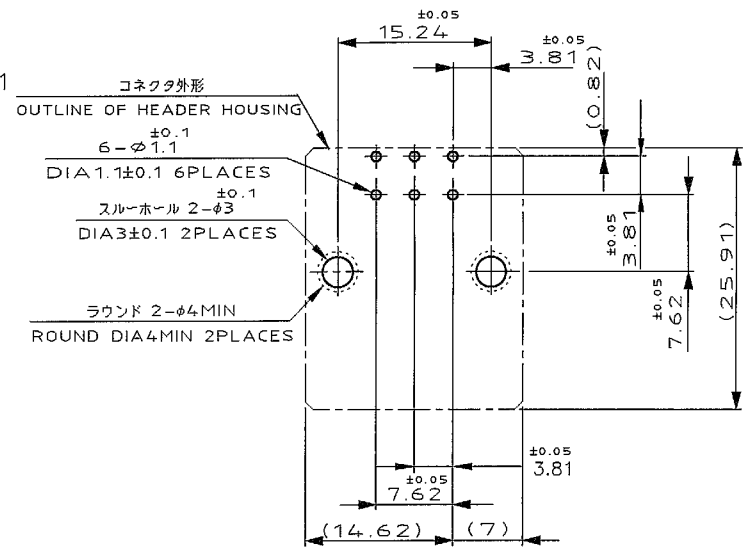
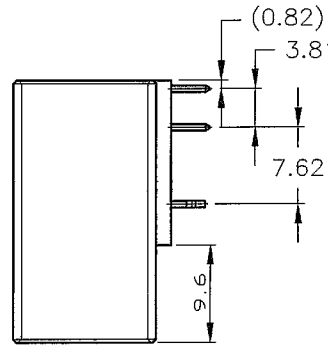
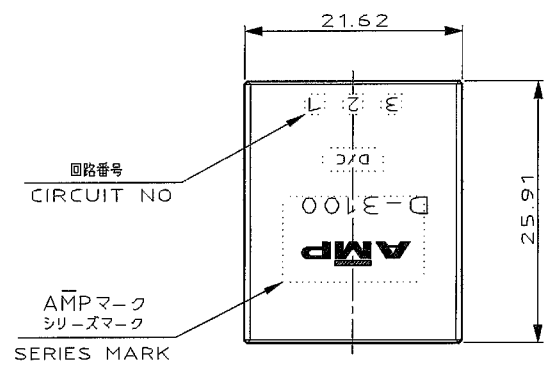


METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/83



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエスチル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の土にスズめっき

△6	△4	178303-5
△6	△3	178303-3
△6	△2	178303-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

C	REVISED (FJ00-0039-03)	T S S M	4/15/93
B	REVISED (FJ00-0097-03)	T S S M	3-23/93
A	REVISED (FJ00-2183-95)	K I S M	3-23/95
0	RELEASED (J-1184)	N M	3-4/92
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK

Copyright © 1991
AMP (Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

tyco Electronics | Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan

WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME	ダイナミック D3100 水平タイプ 6 極 ヘッダーアセンブリ 6 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100
MATERIAL	FINISH	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC NUMBER
SEE NOTE	SEE NOTE	100% ±0.3 30% ±0.4 50% ±0.45	A3 J C-178303
DR. N. Matsubara 14 JUN 91	DE. N. Matsubara 14 JUN 91	SCALE	REV. C SHEET 1 OF 1
CHK. H. Ogata 24/FEB/92	APP. S. MANABE 4/MAR/92	2-1	

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面